

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成26年2月27日(2014.2.27)

【公表番号】特表2014-501185(P2014-501185A)

【公表日】平成26年1月20日(2014.1.20)

【年通号数】公開・登録公報2014-003

【出願番号】特願2013-543491(P2013-543491)

【国際特許分類】

B 3 2 B 27/30 (2006.01)

B 6 5 D 85/86 (2006.01)

B 6 5 D 65/40 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 27/30 1 0 2

B 6 5 D 85/38 N

B 6 5 D 65/40 D

【手続補正書】

【提出日】平成25年12月17日(2013.12.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子素子をパッケージングするためのヒートシールフィルムであって、  
ベース層と、

前記ベース層上に設けられる少なくとも1つの中間層であって、前記中間層の全重量を  
100重量%として、

5～70重量%の酢酸ビニルコポリマーであって、酢酸ビニルに由来する単位がコポリ  
マーの10モル%超を構成する酢酸ビニルコポリマーと、

20～90重量%のスチレンブタジエンコポリマーと、

0～40重量%の導電性ポリマーと、を含む、混合物を含む中間層と、

前記中間層の、前記ベース層とは反対側の表面に設けられる少なくとも1つのヒートシ  
ール層と、を備えるヒートシールフィルム。

【請求項2】

前記ヒートシール層が、ヒートシール層全体の全重量に対して60%以下の含有率の導  
電性充填剤を更に含む、請求項1に記載のヒートシールフィルム。

【請求項3】

電子素子を備えるキャリアテープをヒートシールするためのカバーテープであって、  
ベース層と、

電荷を消失させるためにベース層上に配置された中間層であって、前記中間層の全重量  
を100重量%として、

5～70重量%の酢酸ビニルコポリマーであって、酢酸ビニルに由来する単位がコポリ  
マーの10モル%超を構成する酢酸ビニルコポリマーと、

20～90重量%のスチレンブタジエンコポリマーと、

0～40重量%の導電性ポリマーと、を含む、混合物を含む中間層と、

中間層上に配置されたヒートシール層と、

前記ベース層の、前記中間層とは反対側の表面に配置された、場合により設けられる帶

電防止コーティングと、を備え、

前記カバーテープの平均光透過率が少なくとも 75 % であり、光学的ヘイズ値が 50 % 以下であり、表面抵抗率が  $1 \times 10^{11}$  以下であることにより、前記カバーテープがキャリアテープにヒートシールされて物品を形成する際、前記キャリアテープに対する前記カバーテープの平均剥離強度が少なくとも 20 gf/mm (196 N/m) であり、物品が 50 以上の温度及び 90 % 以上の相対湿度に少なくとも 5 日間曝露された場合の剥離強度の低下が 10 % 以下である、カバーテープ。